框架结构总览 APP层对机. 器人实际的 功能模块进 行定义和封 装,并在模 RobotC Gimbal Shoot发 Chassis Gripper HAL层使用 块中使用 APP层 MD模块 云台 底盘 射 夹爪 BSP层的接 HAL层封装 口和库完成 的外设驱动 来实现控制 对外设的封 目标。而 装,形成外 Monitor外设 设驱动,将 HAL层 Drivers 外设驱动封装 Sub/Pub消息 机制 电机、裁判 机制使得各 系统、遥控 个模块间可 器等外设抽 以完全独 立。在所有 象为对象。 BSP层 **GPIO** CAN **UART** SPI 模块中, RobotCMD模 块是不可或 缺的总控制 BSP层为底层硬件进行封装,对接口进行编 模块。它负 号和映射, 使得软硬件分离, 方便移植 责处理信息 以及给其它 模块发送控 制指令。